

2024 年 10 月 30 日

研究員：陳俐妍 ly.c@capital.com.tw

前日收盤價	126.00 元
目標價	
3 個月	153.00 元
12 個月	153.00 元

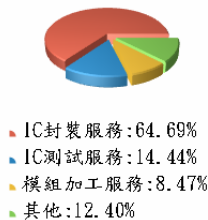
## 近期報告日期、評等及前日股價

09/26/2024	Buy	139.00
07/31/2024	Trading Buy	169.00
05/02/2024	Trading Buy	174.50
01/31/2024	Neutral	148.50
12/28/2023	已達目標價	

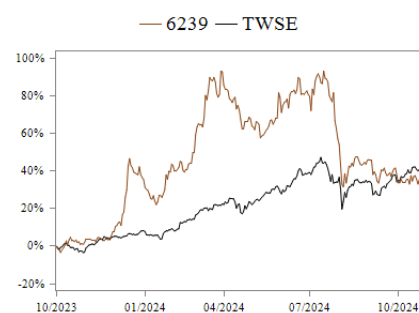
## 公司基本資訊

目前股本(百萬元)	7,591
市值(億元)	957
目前每股淨值(元)	70.26
外資持股比(%)	36.51
投信持股比(%)	29.71
董監持股比(%)	6.42
融資餘額(張)	3,760
現金股息配發率(%)	65.30

## 產品組合



## 股價相對大盤走勢



## 力成(6239 TT)

Buy

營運平穩，維持 Buy，目標價 153 元。

**投資建議：**地緣政治議題及通貨膨脹居高不下，減緩全球經濟成長復甦力道。企業面臨高能源費用、高利率及高不確定性等挑戰。2025 年力成將受惠新終端產品陸續推出如新型手機、AI servers、EV car，皆將帶來新需求。因此力成樂觀看待 2025 年營運，預估力成 2025 年稅後 EPS 10.93 元。雖然近期消費性較差，但力成在新產品量產增加下，營運仍屬平穩，2024 年本業比 2023 年成長，若無意外，股利配發將維持 2023 年水準，預期將配發現金股利 6.5 元以上，現金殖利率約 5%維持 Buy，目標價 153 元(PER14X)。

**3Q24 稅後 EPS 2.24 元：**力成西安廠出售給 Micron(MU US)，於 06/28/2024 完成交割。西安廠佔力成單月合併營收 5 億左右，因此 3Q24 營收將影響 12~15 億元。力成 3Q24 營收為 183.02 億元，QoQ-6.56%，其中力成母公司部份為 144.42 億元，QoQ-7.43%。2Q24 DRAM 佔總營收比重下滑至 19%。NAND Flash 增加至 31%。SiP/Module 佔營收比重增加至 10%，邏輯則比重上漲至 40%。毛利率上揚主要是因為產能利用率增加和產品組合改變，以及出售毛利率較低西安廠，3Q24 毛利率增加至 21.45%，業外 6,300 萬匯損，力成 3Q24 稅後 EPS 2.24 元。

**預估 4Q24 稅後 EPS 2.45 元：**AI 應用正由雲端擴展到終端 AI PC，AI phone 等產品，帶動高階邏輯晶片與高速高密度記憶體晶片的需求。不過 PC/NB、smartphone 及消費性產品等的需求趨緩，車用產品銷售不如預期。4Q24 DRAM 市場需求平緩，力成期待各記憶體業者 HBM 擴產的外溢效應下，帶來業務增長。力成 HBM 專案開發進行中，有機會在 4Q24 與 1Q25 陸續量產 HBM 產品。smartphone、PC 等應用產品未見到預期的換機潮 整體消費市場對新產品的需求延後，4Q24 消費性產品的 NAND Flash 成長將持平。邏輯方面，Tera Probe/TeraPower 因 4Q24 消費型記憶體、汽車晶片與邏輯晶片的需求較 2024 年初預期為低。不過大型語言學習 AI 晶片、AI 應用晶片等將自 4Q24 逐季成長。預估力成 4Q24 稅後 EPS 2.45 元。2024 年稅後 EPS 9.38 元。

(百萬元)	2023	2024F	2025F	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24F	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F
營業收入淨額	70,441	74,091	78,472	18,449	19,034	18,329	19,586	18,302	17,874	17,755	19,288	20,709
營業毛利淨額	12,609	14,403	16,447	3,276	3,910	3,207	3,726	3,926	3,544	3,482	4,165	4,473
營業利益	8,154	9,906	11,666	2,017	2,584	2,045	2,577	2,769	2,516	2,434	3,031	3,265
稅後純益	8,009	7,121	8,300	1,573	3,965	1,737	1,828	1,700	1,856	1,852	2,216	2,278
稅後 EPS(元)	10.55	9.38	10.93	2.07	5.22	2.29	2.41	2.24	2.45	2.44	2.92	3.00
毛利率(%)	17.90%	19.44%	20.96%	17.76%	20.54%	17.50%	19.02%	21.45%	19.83%	19.61%	21.60%	21.60%
營業利益率(%)	11.58%	13.37%	14.87%	10.93%	13.58%	11.15%	13.16%	15.13%	14.07%	13.71%	15.71%	15.76%
稅後純益率(%)	11.37%	9.61%	10.58%	8.53%	20.83%	9.47%	9.33%	9.29%	10.38%	10.43%	11.49%	11.00%
營業收入 YoY/QoQ(%)	-16.07%	5.18%	5.91%	7.15%	3.17%	-3.70%	6.86%	-6.56%	-2.34%	-0.66%	8.63%	7.37%
稅後純益 YoY/QoQ(%)	-7.81%	-11.08%	16.56%	17.13%	152.05%	-56.20%	5.28%	-7.02%	9.18%	-0.20%	19.62%	2.82%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；稅後 EPS 以股本 75.91 億元計算。

2024 年 10 月 30 日

## 力成 ESG：

(一)力成依據 TCFD 的框架，透過治理、策略、風險管理、指標和目標等四項核心要素，進行氣候變遷的風險與機會鑑別，並根據鑑別結果訂立因應措施，藉以降低氣候風險的衝擊，並掌握氣候機會帶來的效益。

1.以 TCFD 架構檢視氣候變遷的情境分析、識別對企業營運所帶來的風險與機會。2.每年實施 ISO14064 溫室氣體盤查，了解排放源與排放量。3.倡議 SBT 科學減碳目標及每年揭露 CDP，持續落實與改善。4.主要二氧化碳排放皆來自用電，因此，擬定綠電目標及使用再生能源政策，降低用電量。5.制定節能減碳目標，運行於各生產區，2021 年執行共 130 項節能減碳措施，藉以達到減少能源耗損及溫室氣體排放。

(二)1.力成科技主要二氧化碳排放皆來自用電，2021 年度共計節電 13,036,455kWh，約 46,931.2 焦耳 (GJ)，達到減少 1%用電量的節電目標。2.規劃在 2025 年達到 10%綠電設置量，以及朝向 2050 年達到淨零排放之目標前進。

(三)力成積極實施節能與溫室氣體減量活動，每年訂定節能目標及提升用電效率，也提供相關的推行措施鼓勵、實質獎勵主管及員工共同參與節約能源，連結 SDGs-13 目標－氣候行動之對抗氣候變遷及其影響。1.2021 年力成台灣共計減少用電量約 13,036,365 kWh，約減少 6,544 噸二氧化碳當量的排放。2.針對廠區內執行共 130 項節能減碳措施，藉以達到減少能源耗損及溫室氣體排放。3.2022 年已陸續建置太陽能發電設備並將於 2023 年開始供電，再生能源供應商亦於 2023 年供應綠電並提供所取得的綠電憑證，預期可使用 750 萬度綠電。4.朝向 2050 年達到淨零排放之目標前進

(四)企業產品或服務帶給客戶或消費者之減碳效果。1.每年達到節電 1%的目標，持續減少用電量。2.提升能源使用效率，由 2021 年 68.5(元/kWh)提升至 68.2(元/kWh)，上升 4%。3.力成竹科三廠(P11B)新廠於 2H21 落成啟用，廠區具有綠建築合格證。4.開發出面板級扇出型封裝 (Fan-Out Panel-Level Packaging, FOPLP) 先進製程，因應終端產品所需功能與效能日益增加，扇出型封裝製程以重分佈層技術可將封裝技術延伸至異質整合，得以讓更多晶片達到高度整合、薄型化、高可靠度、散熱佳及電氣性能更優秀等功能。相較於晶圓級扇出型封裝(Fan-Out Wafer-Level Package, FOWLP)可減少不完整邊緣晶片(Edge Die)耗損問題，並大幅提升面積使用率(FOPLP:95% > FOWLP:85%)及產能(同尺寸面板較晶圓多 1.4 倍)，具有顯著提高生產效率及降低成本之優異表現，更具省電、更環保。

**不再認列西安廠 DRAM 營收，力成 3Q24 營收 183.02 億元，QoQ-6.56%，稅前淨利 27.04 億元，QoQ-7.55%，稅後 EPS 2.24 元：**

力成西安廠出售給 Micron(MU US)，於 06/28/2024 完成交割。西安廠佔力成單月合併營收 5 億左右，因此 3Q24 營收將影響 12~15 億元。力成 3Q24 營收為 183.02 億元，QoQ-6.56%，其中力成母公司部份為 144.42 億元，QoQ-7.43%。

3Q24 記憶體方面，DRAM 方面，標準型記憶體(Commodity)QoQ、YoY 皆呈減少，若不含西安，則 QoQ、YoY 為增加態勢。手機用 DRAM 出貨量成長穩定，QoQ 增加、YoY 略減於低個位數符合預期。雖然近期車用需求較

2024 年 10 月 30 日

差，QoQ+0%，但 YoY 營收還是呈現成長。NAND Flash 部分，NAND Flash 主要成長來自 SSD，SSD 以數據中心/人工智慧服務相關復甦中，營收繼續增長。零組件則隨著 SSD 出貨增加，技術較難，要做到 20 幾個疊在一起，unit price 高。固態硬碟 SSD 客戶持續下單，QoQ/YoY 皆呈個位數成長。

邏輯業務，3Q24 超豐營收 38.60 億元，QoQ-3.15%，面板、PC、NB 等回補庫存告一段落，短單及急單需求仍多，市場能見度低。MCU 受備貨長短料影響，急單需求增加。來自大陸的訂單增加，Tera Probe/TeraPower 需求不錯。力成 PTI 營收 QoQ 減低個位數，YoY 年增高個位數。Tera Probe/TeraPower QoQ 成長，YoY+0%，較往年表現較差，因為工業用和車用產品需求低於預期。

力成整體產品營收比重方面，3Q24 DRAM 佔總營收比重，因西安廠出售，下滑至 19%，較 2Q24 的 24% 明顯下滑。NAND Flash 佔力成營收比重從 27% 增加至 31%。SiP/Module 佔營收比重增加至 10%，邏輯則佔 3Q24 營收比重維持 40%。若以產品項目來看，測試佔營收比重 23%，產能利用率較 2Q24 成長，SiP/Module 佔營收比重減少至 10%，Package 佔營收比重維持 67%。

以終端應用別來看，Automotive(ex:EV,ADAS)佔營收比重從 2Q24 的 13% 增加至 14%，Communication(ex:Mobile ,Networking,Wireless,AR,)佔營收比重為 30%，較 2Q24 的 26% 成長。Computing (ex:PC , Server, HPC , cloud)佔營收比重較 2Q24 的 28% 明顯下滑至 21%，主要是因為減少西安的營收。Consumer(ex: TV, IOT games,camera,PDA,Smart home)佔營收比重持平 25%。Industry (ex:Automation, Medical, Power)佔營收比重 2%。AI related 則穩定增加中，佔 3Q24 營收比重 8%。

3Q24 毛利率增加至 21.45%，較 2Q24 的 19.02% 增加 2.43 個百分點，主要是因為較低毛利率的西安廠出售，加上產能利用率和產品組合的改善，3Q24 產能利用率從 2Q24 的 75%，增加至 80%，業外部份，主要是新台幣升值，產生 6,300 萬匯損。力成 3Q24 稅前淨利 27.04 億元，QoQ-7.55%，稅後 EPS 2.24 元。

力成西安廠出售給 Micron(MU US)，於 06/28/2024 完成交割。西安封測廠的土地及廠房為 Micron 所有，人員及機器為力成資產，合約終止後機器設備將以帳面價值轉移，無處分損益。

**力成集團將 2024 年整個集團資本支出 150 億元，著重在 HBM 等高階產能投資：**

客戶減產與調整庫存，力成 2023 年資本支出約為 74.5 億，YoY-60%，為全力衝刺 AI 用 HBM 封測與先進封裝商機，力成將 2024 年資本支出從 100 億元增加至 150 億，YoY+101.34%，調升至 150 億主要用於 TSV for HBM、FCBGA、testing。資本支規劃方面，100 億投資在力成本身，其中 60% 用於 HBM 相關，擴充的產能可支援至 2025 年中；50 億則投資在超豐/Tera Probe/TeraPower，

熊本廠和台灣廠如期擴充，因為車用電子將從 40nm 轉至 28nm，未來測試時間會變長，需要更先進的機台，因此資本支出較高。若以項目來看，封裝將高於測試。2024 年資本支出部份還是會放在先進製程為主，包括 Wafer Level CSP，及已量產的 Flip Chip 新產品和 SiP 等，如 Bumping 或 HBM 相



2024 年 10 月 30 日

關。竹科分公司現在主要提供晶圓級封裝、IC 封裝及先進 3D-IC 模組封裝，測試開發與服務。由於高階的機台需要 8 個月到 1 年 lead time，為配合新業務，預估力成 2025 年資本支出將會維持在 100~150 億元。

全力衝刺 AI 必備的高頻寬記憶體 (HBM) 封測與先進封裝商機，並在當紅的 HBM 領域已有 2、3 個客戶洽談中，力成原本是用 Micron NCF(non-conductive film)，Samsung 也是用此技術堆疊。但公司 MUF 技術後發先行，開始有客戶來談，看來會較 NCF 先量產。由於高階 HBM 還是掌在原廠手中，力成會先從 HBM2/HBM2E 開始出貨，難度較低，良率高。此外力成也和華邦電合作，包括但不限於 Chip on Wafer、Bumping 及 TSV via-reveal 封裝等。華邦電新一代的矽中介層技術，是在開發 CUBE DRAM 系列的伴隨產品，專攻高效能 AI 邊緣運算，結合力成 2.5D/3D 異質整合封裝技術。力成的面板級封裝技術能滿足各方面的應用需求。與各客戶合作新專案導入積極進行中，將有助於未來先進封裝的營收比重增加。因應訂單與擴產資金需求，2024 年資本支出調高至 150 億元，較 2023 年大增逾一倍。

12 吋 Bumping 產能，台灣部份為 110K wafer/月，主要產品為 Graphic Memory、HPC 等等。12 吋高階電鍍 Bumping 服務為 Flip Chip 與 Wafer level package 的關鍵製程之一，Flip chip 產能 70M/月(超豐則 100M/月)，將會持續擴充，memory 產品的 controller 大都會採用 FC 的 solution，high-end AI 應用 FCBGA、大顆的 FC 都很熱門，2Q24 開始設備陸續送達。

TSV 則以影像處理為主，運用之前和聯電、Elpida(Micron)合作的 TSV 產能和技術發展 WLCSP 用於醫療(全球基因定序檢測龍頭 illumina)、監控、自動化及工業用的 CIS CSP 從 4Q23 開始小量生產(LVM)，2024 年開始量產(HVM)，已經從最早消費性安全監控跨入工業用和車用(TOF)。2Q24 起有更多來自不同客戶的專案引入 PTI。公司的良率達 95% 以上，優於同業 85%，因為是採 TSV 技術，所以 die size 比較小。將有助於 2025 年營收的增長。

SMT 產線主要是支援 SiP，現在是以 SSD 和記憶體模組為主，近期加入 power module(功率模組)，Power module 取代 Dr.Mos，因為 AI power 需求很高，2Q24 有小量產出，3Q24 量會增加，4Q24 會有不錯的營收貢獻，佔 2024 年營收個位數，力成是從 Bumping 開始，一條龍的供給。不過 SMT 線 lead-time 很短，長則 5 天，短則 3 天，未來還是要觀察市場的情況，調整資本支出。

折舊費用方面，2022 年折舊費用較 2021 年 145 億元略為增加至 148 億元，2023 年折舊費用約 136 億元，由於 2023 年資本支出折舊大幅下滑，預估 2024 年折舊費用 120 億元。

### 力成發展 FOPLP 已久，專注在異質整合：

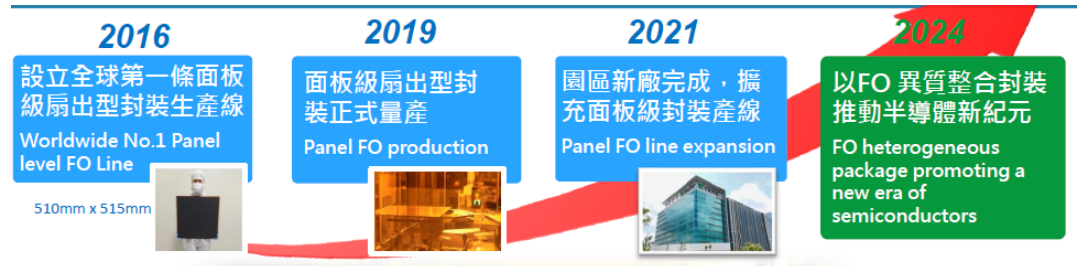
力成 2016 年就發展 FOPLP，尺寸為 21 吋(510X515)Panel Level Fan-out，Panel 是 12 吋 wafer 面積的 3.4~3.5 倍。當時沒有標準的規格，因此設備廠無法開發，只能客製化，產線設置較不易。現在 JEDEC 有 2 個規格，510X515 和 600X600(日月光購買美國公司) Panel Level Fan-out Panel，因此力成目前是主流的規格。力成 Fan-out 最大月產能將可達到 40~45K/月 panel，約 120K 片 12 吋晶圓，現在群創做 power module 部份，力成和日月光早已量產，群創用的是 620X750 Panel size，和 OSAT 的規格不同

2024 年 10 月 30 日

力成除提供 FOPLP，也有 FOWLP，主要是因應客戶的需求。晶圓廠主要是線寬/線距為 1um 以下，OSAT 廠則是 2~5um。力成線寬線距 2/2 在認證中，公司機台可以做到 1/1。

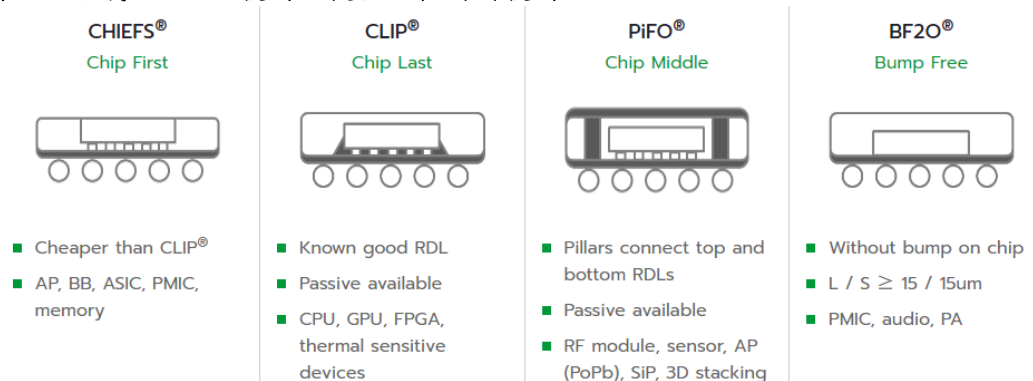
FOPLP 公司主要是專注在異質整合的產品，產品開發大都要 2 年以上，營收貢獻較慢。

圖一、Panel Fan-Out in PTI



資料來源：力成，群益預估彙整

圖二、力成 FOPLP 技術上提供 4 種封裝技術



資料來源：力成，群益預估彙整

**AI 帶動成長，預估力成 4Q24 營收 178.74 億元，QoQ-2.34%，稅前淨利 28.44 億元，QoQ+5.18%，稅後 EPS 2.45 元：**

力成表示 AI 是當前半導體晶片成長的主要力道。AI 應用正由雲端，迅速擴展到終端 AI PC，AI phone 等產品，帶動高階邏輯晶片與高速高密度記憶體晶片的龐大需求。相較來說 PC/NB、smartphone 及消費性產品等的需求趨緩，車用產品銷售不如預期，國際大廠積極應對庫存調整 以因應需求放緩。全球局勢依然緊張，俄烏戰爭未見停止跡象，中東緊張局勢持續高漲 衝擊全球經濟。此外美國總統大選結果將牽動全球政經變化 並須關注美國降息對經濟與匯率的影響。

DRAM 方面，DRAM 市場需求平緩，期待各記憶體業者 HBM 擴產的外溢效應下，帶來業務增長。並持續強化與其業務合作的各項產品機會除現有量產產品 DDR、LPDDR、GDDR 之外 為滿足客戶在高頻寬高速度高容量的 AI server、AI PC 需，力成將善用記憶體封裝薄片與晶片堆疊的技術優勢持續開發新型態封裝產品。AI server 持續帶動 4Q24 記憶體需求，運算需求越高，記憶體的需求量也較多。力成 HBM 專案開發也進行中，有機會在 4Q24

2024 年 10 月 30 日

與 1Q25 陸續量產 HBM 產品，主要是和日本客戶合作開發。

NAND 和 SSD，由於 smartphone、PC 等應用產品未見到預期的換機潮，整體消費市場對新產品的需求延後，4Q24 消費性產品的 NAND Flash 成長將持平。不過 AI Cloud 應用需求依然強勁帶動 NAND 企業級產品在 4Q24 到成長。SSD 業務隨著伺服器與資料中心的擴張持續穩健向上。AI 應用與伺服器對高容量 NAND 的要求，帶動 NAND 堆疊數量提升。晶圓薄化、薄片堆疊等封裝能力將是晶片堆疊封裝的關鍵，力成在 NAND 封測長期深耕，將受惠晶片堆疊的封裝需求。SSD 朝向高容量發展 130TB 以上發展，需求穩健上升。

邏輯晶片方面，超豐部份，雖然消費性終端客戶庫存恢復健康水位，但景氣復甦力道不足，市場需求能見度不高，客戶備貨意願維持保守。惟新客戶量產需求效應將有助於平緩營收的下降。面板和白牌手機有短單及急單需求，4Q24 大尺寸需求減少，中小尺寸需求持平。力成本身積極強化邏輯產品業務的成長，新產品的驗證與量產導入依計畫進行。其中 Power module，大尺寸 FCBGA，及 PoP b 等產品的營收貢獻逐漸發酵。相較於記憶體封測業務，邏輯產品的營收具更高的成長性。先進封測產品的開發與產能擴充，客戶新產品開發及驗證持續進行中。Tera Probe/TeraPower 因 4Q24 消費型記憶體、汽車晶片與邏輯晶片的需求較 2024 年初預期為低，主要客戶持續調降其 2024 年底的庫存水位。不過伺服器晶片業務持續成長。大型語言學習 AI 晶片、AI 應用晶片等將自 4Q24 逐季成長。

毛利率則因產能利用率和 3Q24 相近或微幅下滑，大致和 3Q24 差不多。預估力成 4Q24 營收 178.74 億元，QoQ-2.34%，稅前淨利 28.44 億元，QoQ+5.18%，稅後 EPS 2.45 元。預估力成 2024 年營收為 740.91 億元，YoY+5.18%，稅前淨利 111.92 億元，YoY-7.07%，稅後 EPS 9.38 元。

**新產品帶動營收成長，預估力成 2025 年營收為 784.72 億元，YoY+5.91%，稅前淨利 131.07 億元，YoY+17.11%，稅後 EPS 10.93 元：**

力成以往因記憶體客戶集中度高，受單一客戶的影響較大。力成在記憶體產業耕耘以久，記憶體產業寡佔的特色也不易改變，記憶體廠和封測廠的關係緊密，也不易動搖，記憶體產業一向波動很大，因此力成 2012 年開始就不斷擴產邏輯新應用產品。力成近幾年積極從記憶體封測跨足邏輯 IC 封測，集團提供全方位產業封測服務，日月光(3711 TT)、AMKOR(AMKR US)是力成在技術與產能的目標。記憶體封測是力成本業，力成將繼續努力維持記憶體 OSAT 世界第一。DRAM 除與現有客戶加強合作外，爭取與 Mobile 及 Consumer 供應商合作機會、分散風險。NAND Flash 深耕目前策略夥伴的合作關係，配合客戶擴充產能、投資先進技術與策略夥伴共存共榮。整合旗下 3 家公司資源，超豐持續專注封測中低端產品，持續擴建產能增加市佔率。Tera Probe/Terapower 加強與日本、台灣及歐美等國際客戶合作，拓展邏輯晶圓及成品測試。力成科技-以既有的記憶體先進封測技術為基礎，積極拓展高階邏輯及異質整合的客戶及產品。

2025 年力成將受惠新產品推出。1) Ultra-Large size FCBGA，尺寸 80x80mm 已在量產，用在 SOC+Chiplets integration，應用產品包括 AI、Cloud、auto application 等。2) 以 TSV 連結的 CIS CSP 不管是否有附光學玻璃鏡片均可以量產，CIS CSP 2024 年開始量產(HVM)。公司的良率達 95% 以上，優於同業 85%，因為是採 TSV 技術，所以 die size 比較小。力成剛開始是做 Via



2024 年 10 月 30 日










last 和 Elpida 合作開發，之前用機械式(Disco)研磨，精細度較低，研磨機一台約 4,000~5,000 萬元，不過展望未來趨勢，公司投資晶圓廠使用的 CMP，一台 CMP 要台幣 2 億元，因此 2024 年力成具有記憶體 Via middle 晶圓 Via reveal 之能力，結合原本力成 HBM 堆疊技術，力成將成為少數 OSAT 具備 HBM Via middle 封裝能力的公司。專案開發進行中，力成有機會在 4Q24 與 1H25 陸續量產 HBM 產品。HBM 領域已有 2~3 個客戶洽談中，跟日本 Fabless 合作，solution 不太一樣需要花點時間，客戶仍在驗證技術，個別客戶 HBM 牽涉良率問題，不太可能會把整個產品外包，但力成可以做 bumping、後段封裝等，此部份 2025 年營收將有明顯貢獻。3)多年來開發的大面板尺寸 FO Chip first、Chip last、Chip middle 等先進 2.5D/3D 封裝將開始迎接新應用的到來。TSMC Interposer 線寬少於 1um，約 0.4um，大部份 OSAT 沒有辦法達到這個精細度，因此力成與華邦電(2344 TT)結盟開發細線寬、細 TSV 直徑的 Si interposer，結合已有的先進封裝堆疊技術，預期 2024 年底能提供客戶類 TSMC CoWoS 的選項，最快 2025 年才有營收貢獻。

3)APU 使用的 HB POP-b 在 2024 年量產(HVM)，小晶片大尺寸採用 FCBGA 解決方案，在 04/2024 小量生產(LVM)。小晶片 (Chiplet) 大尺寸採用 FCBGA(80mmX80mm)，如 SOC 可能用 N5/N3 製程，但旁邊的 controller 或 IO 是用 N28，共同封裝在 ABF 載板上，100~200 美元/片 20 幾層 ABF 將由客戶 consign，力成僅提供服務。

4)用於人工智慧、伺服器、電動汽車等的電源模組/電源塔 2Q24 量產(HVM)，公司是利用原有 SSD 技術，一台 EV 有 20 幾個 power module，未來營收貢獻不小。而用於 AI 伺服器的 Power Module 將在 2Q24 底開始量產，已與客戶討論近一年的時間，花很多工程資源，可以說最成熟的技術，4Q24 初量會逐漸增加。

地緣政治議題及通貨膨脹居高不下，減緩全球經濟成長復甦力道。企業面臨高能源費用、高利率及高不確定性等挑戰，不過新創科技將大幅引領產業需求，力成樂觀看待 2025 年營運。預估力成 2025 年營收為 784.72 億元，YoY+5.91%，稅前淨利 131.07 億元，YoY+17.11%，稅後 EPS 10.93 元。

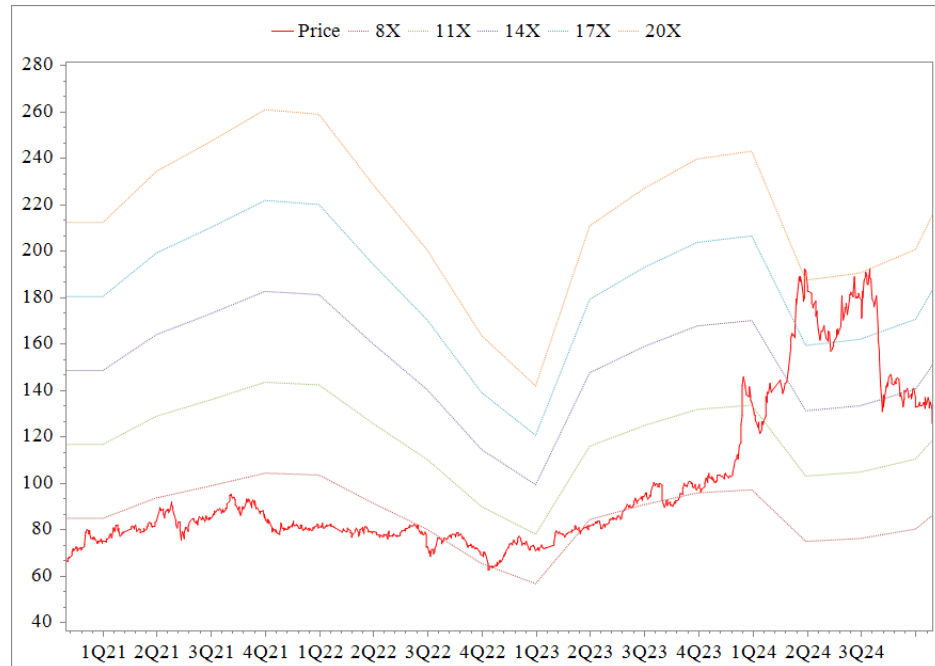
## 力成新產品

 <b>Ultra-Large size FCBGA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Package size ~ 80x80mm MP</li> <li>SOC + Chiplets integration</li> <li>AI, Cloud, auto application</li> <li>Several new devices in qualification</li> </ul> <p>In Production</p>	 <b>CIS CSP (TSV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fine pitch, high I/O,</li> <li>Large sensor area,</li> <li>Excellent performance</li> <li>Application: Safety → Industry, Auto, Mobile</li> </ul> <p>In Production</p>	 <b>PoP-b (for APU)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thin, high performance</li> <li>For flagship smartphone</li> <li>Started production</li> <li>New generations in qualification</li> </ul> <p>In Production</p>
 <b>Power Module</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EV, AI, server application</li> <li>Turkey service: bump → package → assembly → FT</li> <li>Several projects in progress</li> </ul> <p>In Production</p>	 <b>Panel Fan-Out</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>First panel Fan-out line worldwide (since 2016)</li> <li>Mass production for 5 years</li> <li>Working on AI application (Heterogeneous integration)</li> </ul> <p>In Production</p>	 <b>HBM (for cloud &amp; edge AI)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Technology setup in 2009</li> <li>Expanding production capacity</li> <li>NPIs qualification in progress</li> </ul>
 <b>High Density Logic IC Package</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOC + DRAMs</li> <li>High I/O packages (&gt; 3000 wires bonding)</li> <li>For TV chip application</li> <li>Production in 4Q24</li> </ul>	 <b>2.5D IC Package</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si-interposer or Bridge chip solutions available</li> <li>RDL to replace Si interposer available</li> </ul>	 <b>Optical Package (CPO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CPO for SiPhs + GPUs + HBMs</li> <li>For hyperscale AI application</li> <li>Sample verification stage</li> </ul>

資料來源：力成，群益預估彙整

2024 年 10 月 30 日

## Forward PE Band



資料來源：CMoney，群益預估彙整

## Forward PB Band



資料來源：CMoney，群益預估彙整



2024 年 10 月 30 日

## 資產負債表

(百萬元)	2021	2022	2023	2024F	2025F
<b>資產總計</b>	118,587	118,969	111,155	122,545	129,240
流動資產	51,959	49,777	48,194	43,965	53,644
現金及約當現金	22,614	20,373	21,080	18,602	23,098
應收帳款與票據	17,975	14,347	16,679	12,955	14,802
存貨	6,768	10,753	6,681	8,178	8,645
採權益法之投資	--	0	1,174	3,494	2,225
不動產、廠房設備	63,237	64,818	56,924	60,617	64,155
<b>負債總計</b>	<b>55,281</b>	<b>52,646</b>	<b>42,048</b>	<b>49,968</b>	<b>50,766</b>
流動負債	23,319	19,615	16,508	14,844	20,582
應付帳款及票據	6,899	5,594	5,077	5,071	6,140
非流動負債	31,962	33,031	25,540	35,130	29,120
<b>權益總計</b>	63,306	66,323	69,106	72,577	78,474
普通股股本	7,791	7,591	7,591	7,591	7,591
保留盈餘	43,574	45,551	48,242	51,712	57,610
母公司業主權益	49,507	52,289	54,870	56,676	60,421
<b>負債及權益總計</b>	<b>118,587</b>	<b>118,969</b>	<b>111,155</b>	<b>122,545</b>	<b>129,240</b>

## 現金流量表

(百萬元)	2021	2022	2023	2024F	2025F
<b>營業活動現金</b>	24,649	22,923	19,682	24,263	26,462
稅前純益	14,705	13,640	12,043	11,192	13,107
折舊及攤銷	14,052	14,855	13,614	12,983	12,799
營運資金變動	-3,275	-1,662	1,224	2,222	-1,247
其他營運現金	-834	-3,910	-7,199	-2,134	1,802
<b>投資活動現金</b>	-14,059	-18,927	-5,303	-24,177	-7,264
資本支出淨額	-14,198	-18,402	-8,775	-14,900	-13,589
長期投資變動	383	277	3,296	329	1,071
其他投資現金	-244	-802	177	-9,606	5,253
<b>籌資活動現金</b>	-8,716	-6,761	-13,530	-2,564	-14,702
長借/公司債變動	-2,205	400	-6,747	9,589	-6,009
現金增資	0	0	0	0	0
發放現金股利	-3,856	-5,086	-5,231	-5,314	-4,555
其他籌資現金	-2,654	-2,075	-1,551	-6,840	-4,138
<b>淨現金流量</b>	1,594	-2,241	706	-2,477	4,496
<b>期初現金</b>	21,020	22,614	20,373	21,080	18,602
<b>期末現金</b>	22,614	20,373	21,080	18,602	23,098

資料來源：CMoney、群益

## 損益表

(百萬元)	2021	2022	2023	2024F	2025F
<b>營業收入淨額</b>	83,794	83,927	70,441	74,091	78,472
營業成本	64,499	66,551	57,832	59,689	62,025
<b>營業毛利淨額</b>	19,295	17,376	12,609	14,403	16,447
營業費用	4,770	4,928	4,455	4,497	4,781
<b>營業利益</b>	14,525	12,448	8,154	9,906	11,666
<b>EBITDA</b>	28,939	28,641	25,642	25,395	29,705
業外收入及支出	134	1,082	3,547	1,286	1,441
稅前純益	14,705	13,640	12,043	11,192	13,107
所得稅	2,980	2,888	2,534	2,408	2,655
稅後純益	8,898	8,687	8,009	7,121	8,300
稅後 EPS(元)	11.72	11.44	10.55	9.38	10.93
完全稀釋 EPS**	11.72	11.44	10.55	9.38	10.93

註 1：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主。

註 2：稅後 EPS 以股本 75.91【最新股本】億元計算

註 3：完全稀釋 EPS 以股本 75.91 億元計算

## 比率分析

(百萬元)	2021	2022	2023	2024F	2025F
<b>成長力分析(%)</b>					
營業收入淨額	9.99%	0.16%	-16.07%	5.18%	5.91%
營業毛利淨額	28.39%	-9.94%	-27.43%	14.22%	14.20%
營業利益	35.52%	-14.30%	-34.50%	21.49%	17.77%
稅後純益	33.56%	-2.38%	-7.81%	-11.08%	16.56%
<b>獲利能力分析(%)</b>					
毛利率	23.03%	20.70%	17.90%	19.44%	20.96%
EBITDA(%)	34.54%	34.13%	36.40%	34.28%	37.85%
營益率	17.33%	14.83%	11.58%	13.37%	14.87%
稅後純益率	10.62%	10.35%	11.37%	9.61%	10.58%
總資產報酬率	7.50%	7.30%	7.20%	5.81%	6.42%
股東權益報酬率	14.06%	13.10%	11.59%	9.81%	10.58%

## 償債能力檢視

負債比率(%)	46.62%	44.25%	37.83%	40.78%	39.28%
負債/淨值比(%)	87.32%	79.38%	60.85%	68.85%	64.69%
流動比率(%)	222.82%	253.77%	291.94%	296.18%	260.63%

## 其他比率分析

存貨天數	33.23	48.05	55.01	45.43	49.50
應收帳款天數	71.31	70.28	80.38	72.99	64.55

2024 年 10 月 30 日

## 季度損益表

(百萬元)	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24F	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F	4Q25F	1Q26F
營業收入淨額	17,218	18,449	19,034	18,329	19,586	18,302	17,874	17,755	19,288	20,709	20,721	20,435
營業成本	14,329	15,173	15,123	15,122	15,861	14,377	14,329	14,273	15,122	16,236	16,394	15,821
營業毛利淨額	2,889	3,276	3,910	3,207	3,726	3,926	3,544	3,482	4,165	4,473	4,327	4,614
營業費用	1,048	1,259	1,327	1,162	1,148	1,157	1,029	1,048	1,135	1,208	1,390	1,203
營業利益	1,841	2,017	2,584	2,045	2,577	2,769	2,516	2,434	3,031	3,265	2,936	3,411
業外收入及支出	387	574	2,897	675	348	-65	328	292	397	402	351	361
稅前純益	2,228	2,591	5,481	2,719	2,925	2,704	2,844	2,727	3,427	3,666	3,287	3,772
所得稅	489	598	1,128	613	611	552	632	545	719	733	657	754
稅後純益	1,343	1,573	3,965	1,737	1,828	1,700	1,856	1,852	2,216	2,278	1,953	2,477
最新股本	7,591	7,591	7,591	7,591	7,591	7,591	7,591	7,591	7,591	7,591	7,591	7,591
稅後EPS(元)	1.77	2.07	5.22	2.29	2.41	2.24	2.45	2.44	2.92	3.00	2.57	3.26

## 獲利能力(%)

毛利率(%)	16.78%	17.76%	20.54%	17.50%	19.02%	21.45%	19.83%	19.61%	21.60%	21.60%	20.88%	22.58%
營業利益率(%)	10.69%	10.93%	13.58%	11.15%	13.16%	15.13%	14.07%	13.71%	15.71%	15.76%	14.17%	16.69%
稅後純益率(%)	7.80%	8.53%	20.83%	9.47%	9.33%	9.29%	10.38%	10.43%	11.49%	11.00%	9.43%	12.12%

## QoQ(%)

營業收入淨額	9.38%	7.15%	3.17%	-3.70%	6.86%	-6.56%	-2.34%	-0.66%	8.63%	7.37%	0.06%	-1.38%
營業利益	7.57%	9.56%	28.10%	-20.87%	26.05%	7.43%	-9.13%	-3.24%	24.50%	7.72%	-10.05%	16.17%
稅前純益	27.82%	16.31%	111.51%	-50.38%	7.55%	-7.54%	5.18%	-4.13%	25.69%	6.98%	-10.35%	14.76%
稅後純益	19.12%	17.13%	152.05%	-56.20%	5.28%	-7.02%	9.18%	-0.20%	19.62%	2.82%	-14.26%	26.81%

## YoY(%)

營業收入淨額	-25.99%	-13.91%	3.43%	16.44%	13.76%	-0.80%	-6.10%	-3.13%	-1.53%	13.15%	15.93%	15.09%
營業利益	-54.52%	-28.90%	21.58%	19.46%	39.98%	37.25%	-2.64%	19.06%	17.59%	17.92%	16.73%	40.14%
稅前純益	-49.78%	-27.52%	179.23%	56.02%	31.27%	4.35%	-48.11%	0.26%	17.18%	35.59%	15.58%	38.34%
稅後純益	-51.11%	-34.31%	193.92%	54.03%	36.13%	8.07%	-53.19%	6.67%	21.20%	34.02%	5.24%	33.73%

註1：稅後EPS以股本75.91億元計算

註2：自2013年開始，稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主。

## 【投資評等說明】

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間 $\geq 35\%$
買進(Buy)	$15\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 35\%$
區間操作(Trading Buy)	$5\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 15\%$
	無法由基本面給予投資評等
中立(Neutral)	預期近期股價將處於盤整
	建議降低持股

## 【投資評等調整機制】

投資評等係「首次」給予特定個股投資評等時，其前一日收盤價相較 3 個月目標價之潛在上漲空間計算而得。個股投資評等分為四個等級，定義如上。爾後的投資評等係依循「首次評等」，直到停止推薦。

「強力買進」、「買進」及「區間操作」均有 upside 目標價。差別僅在於，首次評等時潛在報酬率不同。「中立」則無目標價。

一旦我們給予特定個股「強力買進」、「買進」或「區間操作」之投資評等，就是責任的開始，爾後將透過各式研究報告作定期性、持續性追蹤基本面及股價變化，直到停止推薦。

**停止推薦情境：**

1. 達目標價。
2. 雖未達原訂目標價，但檢視基本面、訊息面、籌碼面等多方訊息，研判股價上漲空間已然有限，將適時出具降評報告。
3. 推薦後股價不漲反跌，亦將出具降評報告。

## 【免責聲明】

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，報告中有關未來預測之陳述可能不會實現，因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益，可能會有無預警地上升或下降，產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。